

露笑科技股份有限公司 关于合肥露笑半导体材料有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 9 月 15 日分别与合肥市长丰县人民政府、安徽长丰双凤经济开发区管理委员会签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》和《长丰县招商引资项目投资合作协议》，详见 2020 年 8 月 10 日和 2020 年 9 月 16 日披露的相关公告。

公司于 2020 年 10 月 16 日与合肥北城资本管理有限公司（以下简称“合肥北城”）、长丰四面体新材料科技中心（有限合伙）（以下简称“长丰四面体”）签署了《合资协议》，协议约定三方合作在安徽省合肥市长丰县投资建设“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”（下称“项目”），并共同出资设立一家有限责任公司作为本项目的公司。合资公司名称为“合肥露笑半导体材料有限公司”（以下简称“合肥露笑半导体”），注册资本 2 亿元人民币，该部分资金将主要用于碳化硅厂房的初步建设，公司占 47.5%，合肥北城占 47.5%，长丰四面体占 5%，合资公司为本公司的参股公司，详见 2020 年 10 月 19 日披露的相关公告。

近日，公司接到多位投资者咨询电话和互动易平台的提问，询问关于合肥露笑半导体材料有限公司的进展情况。为使投资者及时、公平了解进展情况，现将相关进展情况公告如下：

截至本公告日，合肥露笑半导体已购置第一期项目工业用地，相关产权证书正在办理过程中。厂房已于 2020 年 11 月底开始开工建设，预计 2021 年 3 月底前主体厂房结项，2021 年 6 月底前一期产线通线点亮，2021 年 9 月底前形成产能。公司将根据项目进度情况及时对项目进展进行披露。

目前相关工作正在积极进展当中，项目整体进展与公司预计无重大差别。

项目后续的建设尚需较大的资金投入和时间投入，存在建设交付周期不达预期、客户拓展未达预期等潜在风险。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日